



DISCO

Kiru · Kezuru · Migaku Technologies



Electroformed Bond Blades NBC-Z SERIES

幅広いアプリケーションに対応する高性能ブレード



ウェーハダイシングから基板切断まで対応する 優れた研削力を持つNBC-Zシリーズ

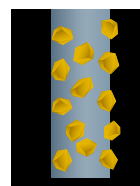
NBC-Zシリーズはディスコ独自の技術が生んだ高性能極薄ブレードです。電鍍タイプのボンドを使用することで優れた研削力とロングライフを同時に実現しました。豊富な製品ラインアップにより、半導体ウェーハのダイシングのほかセラミックスやCSPなど半導体パッケージの切断などにも幅広く対応します。

- 極薄ブレードによる深切り加工や溝入れ加工が可能
- 0.015 mm~0.3 mmのブレード厚さに対応
- 豊富な粒径やボンド品種により化合物半導体ウェーハのダイシングからセラミックスの切断加工まで幅広い加工に対応
- ダイシングソーのほか、スライサーでの使用も可能



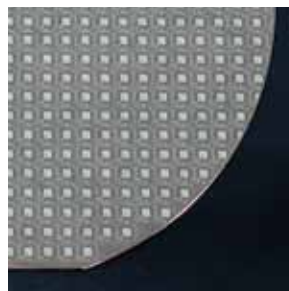
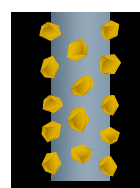
NBC-Zタイプ

ブレード強度を重視した構造により極薄ブレードを実現。狭ストリートのダイシング加工や溝入れ加工などに適しています。

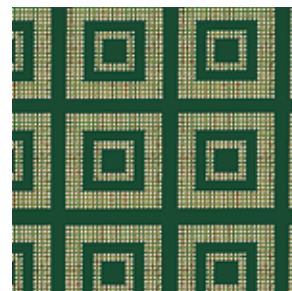


NBC-ZBタイプ

ブレード側面の状態を改善することで表面チッピングや斜め切れを低減し、優れた加工結果を提供します。



シリコンウェーハ



CSP

加工対象

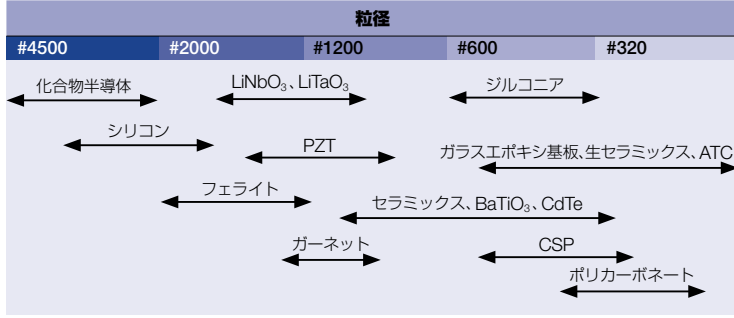
シリコンウェーハ、化合物半導体ウェーハ (GaAs、GaPなど)、各種半導体パッケージ、他

NBC-Z SERIES



加工データ

粒径別アプリケーション



仕様

品種	ボンド	表面処理	
		なし	片面砥粒突出タイプ
Z	O 標準タイプ	L	ラップタイプ Zタイプのみ
ZB	J ソフトタイプ	N	強度向上タイプ
		V	両面砥粒突出タイプ ZBタイプのみ

※1 特殊仕様を含む製品は、ZBT-****と表示する場合があります。

※1 **NBC - Z 1 09 0 L G2 S3 T1** **56 × 0.15 × 40 × 45°**

集中度	粒径	厚さ精度 ^{※2,3}	スリット ^{※4}	先端形状 ^{※5}	外径	厚さ	内径	先端角度
1 低集中度	13 #240 08 #1200	G2 ±0.005	S1 割数 4 深さ 1mm	T1	56	0.15	40	45°
2 標準集中度	14 #280 07 #1500	G3 ±0.002	S2 割数 8 深さ 1mm	T2				
	12 #320 06 #1700	G 特殊仕様	S3 割数 16 深さ 1mm	T3				
	28 #360 05 #2000	(mm)	小割 割数 60 深さ 1mm	T4				
	11 #400 04 #3000	※2 標準精度の場合は表示されません。	大割 割数 12 深さ 2mm					
	25 #500 03 #3500	※3 品種、サイズにより標準精度は異なります。	S5 割数 40 深さ 1mm					
	10 #600 02 #4000		SS 特殊仕様					
	09 #700 27 #4500							
	21 #800 26 #4800							
	24 #1000							

※4 スリット幅は全て0.5 mmです (SSは除く)。
 プレード厚さ0.04 mm以上より対応可能です。
 ※5 プレード厚さ0.1 mm以上より対応可能です。

標準対応範囲 (外径φ63.5 mm未満)^{※6}

集中度	厚さ	粒径 (mm)													
		0.015 ~0.020	0.020 ~0.030	0.030 ~0.040	0.040 ~0.050	0.050 ~0.060	0.060 ~0.065	0.065 ~0.075	0.075 ~0.080	0.080 ~0.100	0.100 ~0.150	0.150 ~0.160	0.160 ~0.180	0.180 ~0.200	0.200 ~0.300
1	26	●													
2	02	●													
	27	●													
	03	●													
	04	●													
	05	●													
	06	●													
	07	●													
	08	●													
	24	●													
	21	●													
	09	●													
	10	●													
	25	●													
	11	●													
	28	●													
	12	●													
	14	●													
	13	●													

● Zタイプのみ対応
 ● ZBタイプのみ対応
 ● O-Jボンドに対応
 ● Oボンドのみ対応

※6 標準対応範囲はタイプにより異なる場合がありますので、詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。

●0.15 mm厚以上のZタイプは標準でラップ処理仕様となります。

弊社製品は全て製造物賠償責任保険がついております。

ご注文に際して

タイプ名・外径・厚さ・内径及び数量をお知らせください。また、新規ご注文の場合は弊社営業担当が選定のお手伝いをさせていただきます。研削材料・寸法・形状・使用機械(装置)その他諸条件を詳しくお知らせください。

・仕様は改良のため、お断りなく変更させていただくことがありますのでご確認の上、ご発注くださいますようお願い申し上げます。

安全にご使用いただくために

プレード、ホイール(以下、精密加工ツール)の破損による事故やケガを未然に防止するために以下の事項を必ずお守りください。

- 安全カバー(ノズルケース、カバー)を使用してください。
- 制限回転数表示のある精密加工ツールは指定の回転数を超えて使用しないでください。
- 精密加工ツールを装着する際は機械(装置)の取扱説明書に従って正しく装着してください。
- 精密加工ツールを落としたり、ぶついたりしないでください。
- 使用する際には必ず毎回精密加工ツールを確認して、欠けやその他破損がある場合は使用中を中止してください。
- ご使用の機械(装置)の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- 改造された機械(装置)は使用しないでください。
- 機械(装置)指定サイズに合わない精密加工ツールは使用しないでください。
- 切断・研削以外の目的には使用しないでください。
- 液式切断の精密加工ツールは冷却液をご使用ください。



株式会社 ディスコ

143-8580 東京都大田区大森北 2-13-11

Phone:03-4590-1000(営業代表) Fax:03-4590-1001 www.disco.co.jp